

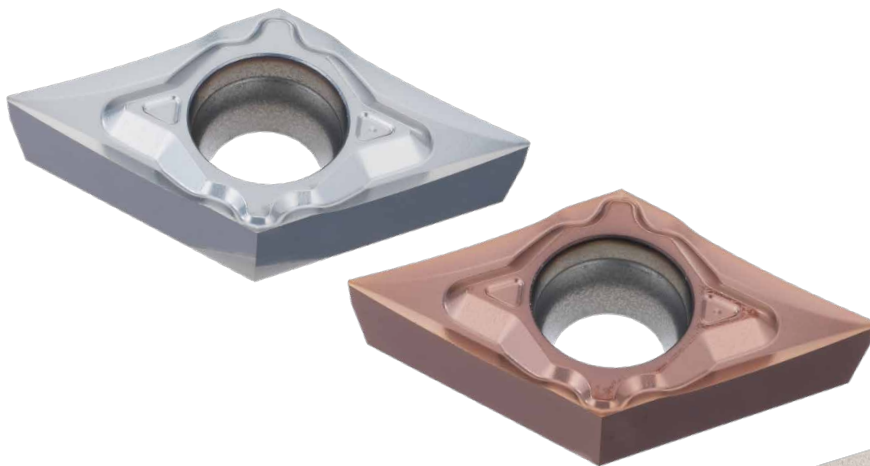
NPN

New Product News



TOP MINI

깊은 절입의 원패스 가공이 가능한
DCGT-ST 인서트



KEY POINT

대구텍은 스위스 자동 선반에서 깊은 절입의 원패스 가공이 가능한 DCGT-ST 인서트를 출시합니다.

신규 칩브레이커가 적용된 DCGT-ST 인서트는 ISO 홀더에 호환 가능한 D타입 2코너 포지티브 인서트로서 높은 경사각 설계로 가공 시 부하가 낮아 안정적인 가공성과 탁월한 공구 수명을 자랑합니다. 또한 하나의 가공 패스로 최대 5.0 mm 깊이의 절삭 가공이 가능하여 가공 패스를 최소화하고 높은 생산성을 발휘합니다.

추가 문의 사항은 담당 PM에게 연락바랍니다.



특징

- 소형 부품 가공용 2코너 포지티브 인서트
- 한 패스로 최대 5.0 mm 깊이의 절삭 가공 가능
-가공 패스를 최소화하여 생산성 향상
- 높은 경사각 설계로 낮은 절삭 부하
- ISO 홀더에 호환 가능

인서트 규격 설명

DCGT 11T302M ST-F
1 2 3

1. M: 코너 반경 마이너스 공차 (ex 02M : R0.2 미만)

2. 칩브레이커명

SL: 얇은 절입 깊이의 정삭용 칩브레이커

SM: 중간 절입 깊이의 중삭용 칩브레이커

SH: 최대 3.5 mm 절입이 가능한 황삭용 칩브레이커

new ST: 최대 5.0 mm 절입이 가능한 황삭용 칩브레이커

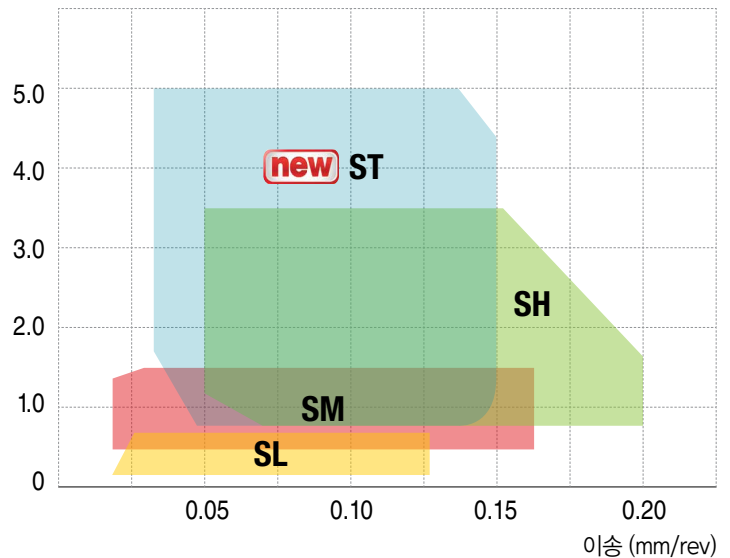
3. 인선 사양

F: 샤프 인선

E: 마이크로 호닝 인선

칩브레이커 영역

절삭깊이 (mm)



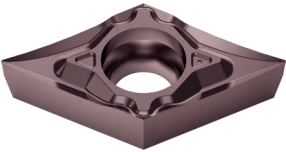
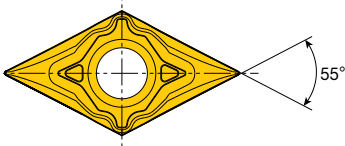
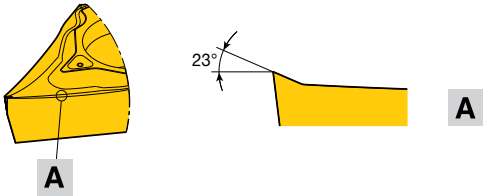
- ▶ 인서트: DCGT 11T302
- ▶ 절삭속도: 80 m/min
- ▶ 피삭재: 스테인리스강 (SUS 304)

가공조건별 칩 형상

-최대 5.0 mm의 깊은 절삭 가공에서도 뛰어난 칩 처리 능력을 발휘합니다.

소재	스테인리스강 (SUS 304)	가공방법	Ø20 외경 터닝	속도	2,000 rpm
절삭깊이 (mm)	이송 (mm/rev)				
	0.05	0.08	0.1		
5.0					
3.0					
1.0					

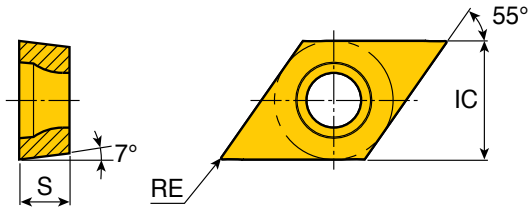
DCGT-ST 인선 형상

칩브레이커	인선 형상	
 <p>ST:황삭용</p>	 <p>55°</p>	 <p>23°</p> <p>A</p>


DCGT-ST new



마름모형(코너각 55°, 여유각 7°), 편면



규격	치수(mm)		
	IC	S	RE
11	9.52	3.97	0.1-0.4

인서트	규격	절삭깊이 (mm)	이송 (mm/rev)	서멧		PVD 코팅								비코팅	
				PV3010	CT3000	TT5080	TT8020	TT9080	TT3010	TT9020	TT9225	TT4410	TT4430	P20	K10
 황삭용 소형부품용	DCGT 11T301M ST-E	0.3-5.0	0.03-0.08											●	
	11T302M ST-E	0.5-5.0	0.03-0.10											●	
	11T304M ST-E	0.7-5.0	0.05-0.12											●	
	11T301M ST-F	0.3-5.0	0.03-0.08							●				●	
	11T302M ST-F	0.5-5.0	0.03-0.10							●				●	
	11T304M ST-F	0.7-5.0	0.05-0.12							●				●	

●: 표준 제품